

# 超高密度微細貫通穴加工 (TGV)

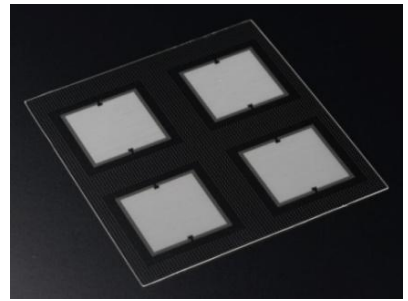
Glass Through-hole Processing



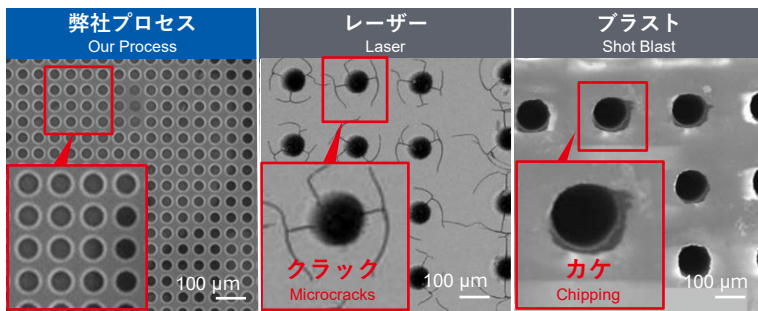
デバイスの集積化、高周波対応を実現  
Realization of high-density and high-frequency device support

## 特長 Special Features

- クラックのない、高密度な微細穴  
Dense microholes without microcracks
- 貫通穴付き基板へ配線形成が可能  
Enables wiring to substrates with through-holes
- 資材調達から一貫対応  
Providing integrated support for all processes starting from material procurement

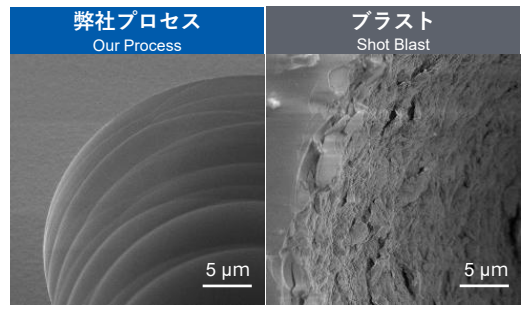


クラック・カケのない、高密度の微細穴加工  
High-density microhole processing without cracks or chips.

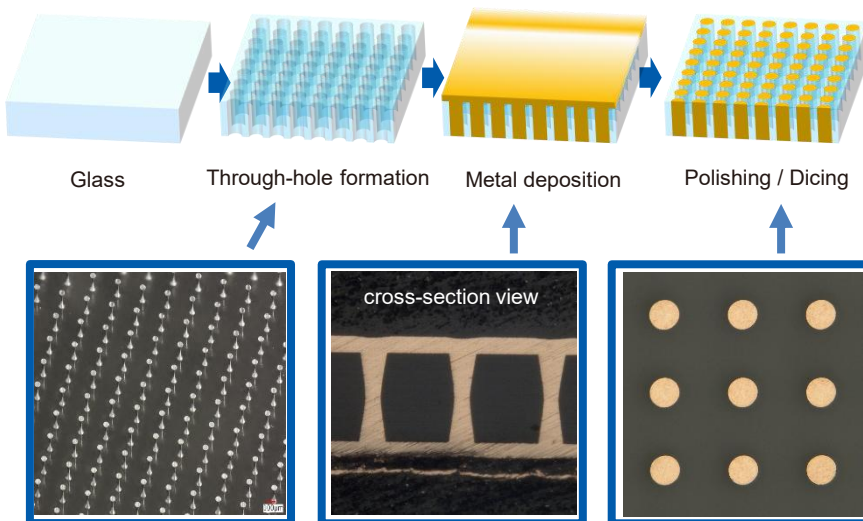


貫通穴の側壁の粗さ:  $Ra \leq 0.08 \mu\text{m}$

The inside walls of our microholes have a roughness of  $Ra \leq 0.08 \mu\text{m}$ .

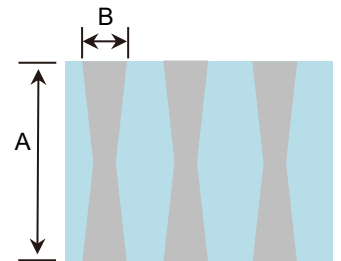


## 処理プロセス Process Flow



## 標準デザイン Standard Design

サイズ Size	100mm~(順次拡大中)
厚み Thickness	~1000μm
アスペクト比 Aspect Ratio	<10(10以上ご相談)



## 対応可能な素材 Substrate Material

無アルカリガラス  
ホウケイ酸ガラス  
合成石英

Alkali-free glass, Borosilicate glass, Synthetic quartz